

Subj:PCN#20126102-A  
(Shipping, Logistics & Marking Changes)

発行日 : 2012年08月24日  
 PCN# : 20126102-A  
 発行者 : National Semiconductor Corporation  
 本PCN発行責任者 : Krintz, Jeff  
 日本語版発行責任者 : 日本テキサス・インスツルメンツ(株)  
 営業技術本部 カスタマードキュメントセンター  
 センター長 牧 達郎  
 日本語版発行担当者 : 吉本 亮

### 情報提供通知

#### ( INFORMATION ONLY NOTIFICATION )

本変更は、以下の製品に対して工程変更が行われることをお知らせするものです。  
 本通知をお読みの上、ご確認ください。  
 本変更に対するお問合せは、代理店または弊社セールス担当者を通じて、ご連絡ください。

**変更項目 :** Top marking /ラベル仕様変更

**実施予定日 :**

2012年08月23日より

**変更内容 :**

National Semiconductor (NSC)の製造とオーダ実行システムのTexas Instruments (TI)のシステムへの統合において、製品のtop marking、出荷梱包ラベルおよび出荷ドキュメントの変更を必要とします。ただし、お客様への混乱を最小限にするために、システムの統合に必要な項目のみに関して、変更を実施いたします。

#### TOP MARKING

A	現(NATIONALSEMICONDUCTOR)	新(TEXAS INSTRUMENTS)
DATE CODE/TRACEABILITY	"UZYWWTT" --> KM1212AB (U) Fab Site, K (Z) Assembly Site, M (YY) Calendar Year, 12 (WW) Calendar Week, 12	"YMLLLL" --> 241234S (Y) Year, 2 (M) Month, 4 (LLLL) Lot Code, 1234 (S) Assembly Site S
デートコードフォーマットを除く、製品のトップマークに変更はありません。なおデートコードフォーマットは"UZYWWTT"から"YMLLLL"への変更を 2012年10月より変更を実施いたします。上記例では、fab がグリーンロック工場、組み立てがマラッカ工場の製品に関して、デートコード表記の相違を記載しています。		

B	現(NATIONALSEMICONDUCTOR)	新(TEXAS INSTRUMENTS)
MICRO SMD PIN 1	Symbol shape method(パンブサイトごとに異なる Pin1 マークの形状を使用)(例. triangle, square)	circle
Pin 1 orientation あるいは Pin 1 top marking 位置の変更はありません。なお、2012年10月初めより変更を実施いたします。		

## ラベル

A	現	新
Intermediate Box	NSC standard (1D barcode)	TI's standard (2D barcode).
IC製品/Sales Die/Sales Wafer品のIntermediate Box (外装箱)のラベルに関して、上記変更(参照NSC v TI Label comparison_PCN20126102b.pdf/page1)を以下の日程で実施いたします。		
1) 2012/8月初めより=> 統合のための在庫の準備を始めるために、Intermediate Box上にNSC1DおよびTI2Dラベルを貼ります。しかし混乱を避けるためTI2Dラベル上には、Customer Specific ラベルあるいは、ブランクラベルを貼り、お客様には、見えないよういたします。		
2) 2012/10月初めより=>お客様へ出荷用のIntermediate Boxには、TI2Dラベルを貼ります。(注 NSC1Dラベル上には、Customer あるいはブランクラベルを貼ります。)		

B	現	新
Sales DIE & Sales Wafers	NSC 1D barcode or NSC text labels	TI 2D barcode or TI text labels
Sales DIE & Sales Wafers に適用しているラベルに関して、上記変更(参照 NSC v TI Label comparison_PCN20126102b.pdf/page3)を 2012 年 10 月初めより実施いたします。それぞれのラベルの適用は以下の通りです。		
1) Sales die を梱包している Waffle tray/Gel Pack tray /Film frame wafer boat およびそれらを密封している Moisture Barrier Bag は TI text ラベルを貼ります。		
2) Sales die を梱包している Surftape reel およびそれらを密封している Moisture Barrier Bag は TI2D ラベルを貼ります。		
3) Sales Wafers を梱包している wafer vials およびそれらを密封している Moisture Barrier Bag は TI text ラベルを貼ります。		
注 2012 年 10 月以降、すべての NSC ラベルの在庫が枯渇するまで、お客様が受け取る、Sale die あるいは Sales Wafer 製品の INTERMEDIATE BOXES 上には、NSC1D、NSC text , TI2D あるいは TI text ラベルが存在することとなります。 NSC および TI ラベルは lot トレースが可能です。また、移行期間中、ドライパック/Intermediate Box/リールのラベルフォーマット/組み合わせは、多様となります。(参照 NSC v TI Label comparison_PCN20126102b.pdf/page2)		

C	現	新
SHIPPING CARTONS	NSC standard (1D barcode)	TI's standard (2D barcode)
IC 製品/Sales Die/Sales Wafer 品の SHIPPING CARTONS のラベルに関して、上記変更(参照 NSC v TI Label comparison_PCN20126102b.pdf/page4)を実施いたします。2012 年 10 月初めより、お客様へのお荷物の際の SHIPPING CARTON には、TI2D ラベルを貼ります。		

## 梱包数

	現	新
PACKING QUANTITY	NSC standard 4 full tray/moisture barrier bag	TI standard 1 full tray/moisture barrier bag
Waffle tray に梱包される Sales Die の Standard Pack Quantity (SPQ)に関して、上記変更を 2012 年 9 月初めより実施いたします。		

## BRANDING

Intermediate Box の BRANDING に関して TI standard (箱状の company logo の表記なし)への変更を 2012 年 8 月初めより実施いたします。

## 出荷ドキュメント

Delivery note および pro forma invoice を TI standard への変更を 2012 年 10 月初めより実施いたします。

注：上記記載の変更品を、受け取る時期は、製品個々の在庫状況枯渇状況に依存いたします。

**変更理由：**

TIによるNSCの買収による統合プロセスの一部として、すべての旧NSCの製造、オーダー実行システムは、TIシステムへの統合を実施いたします。

**変更の影響：**

製品の形状、信頼性、機能、品質への影響はありません。また設計、製造、検査に関しても変更はありません。

**製品識別：**

すべてのサポーターティング・ドキュメントおよび梱包に関しては、完全に、TIプロセスに移行いたします。ただし、製品名は、現行と同じです。